




Параметры	Стандартное значение	Расширенные возможности
Базовые материалы	<p>Печатные платы: FR2, СЕМ-1, СЕМ-3, FR4 (стандартный, безгалогеновый, с улучшенными свойствами) Производства: ShengYi, Elite Materials Corp., ITEQ, Isola, NanYa, KingBoard, GoldenMax</p> <p>Гибкие платы: PI, PET Производства: Taiflex, Dupont, Panasonic, ShengYi</p> <p>Платы на алюминиевом основании: Производства: GoldenMax, Feilong</p>	<p>Печатные платы: ВЧ материалы со средними потерями: TUC TU862HF, EMC EM370D, ITEQ IT170GRA, Panasonic Megtron-2</p> <p>ВЧ материалы с малыми потерями: N4000-13(series), FR408HR, Megtron-4, S7038, S7439, TU872SLK (series), EM-828, EM888, N4800-20(series), I-Speed</p> <p>ВЧ материалы с ультра-малыми потерями: Megtron-6, IT150DA, FX-2, FL-700, I-Tera, N6800-22(series), RO4350B, RO3000(series), RF-35, RF-35A2, TLX (series), AD250, FL-700LD</p> <p>Высокотемпературные ВЧ материалы с ультра-малыми потерями: TU993, M6N, M7N</p> <p>Гибкие платы: PI Производства: Dupont, Panasonic</p> <p>Платы на металлическом основании: Производства: Totking, Polytronics TCB, Doosan DST, Ventec VT, Chin-Shi.</p>
Минимальная толщина диэлектрика (препрега)	0.05мм для жёсткой платы 0.02мм для гибкой платы	0.025мм для жёсткой платы 0.01мм для гибкой платы
Количество слоёв	до 40	до 64
HDI/глухие(слепые)/скрытые отверстия	Y	Y
Заполнение микроотверстий медью		Y
Заполнение сквозных отверстий медью		Y
Восстановление медных площадок на отверстия (via-in-pad)	Y	Y
LDI (Laser Direct Imaging)		Y
Максимальный размер платы, мм	1050 x 610	1400 X 610
Минимальная толщина платы, мм	0.3мм для жёсткой платы 0.1мм для гибкой платы	0.15мм для жёсткой платы 0.05мм для гибкой платы
Максимальная толщина платы	8.6мм	10.0мм
Мин. зазор/проводник	0.075мм	0.05мм

Параметры	Стандартное значение	Расширенные возможности
Финишное покрытие	ENIG, GoldFinger, OSP, ImmAg, HASL (lead), HASL (Leadfree), ImmSn, Carbon	HardGold, SoftGold, ENEPIG
Точность совмещения слоёв	0.05мм	25мкм
Мин. (мех) отверстие	0.15мм	0.10мм
Мин. (лазер) отверстие		0.05мм
Aspect ratio PTH отношение толщины печатной платы к диаметру наименьшего металлизированного отверстия.	18:1	20:1
Aspect ratio BVH отношение глубины глухого отверстия к его диаметру.	0.8:1	1.3:1
Допуск на диаметр металлизированного отверстия	± 0.0375мм	± 0.025мм
Максимальная толщина меди	420мкм	420мкм
Контроль импеданса (волнового сопротивления)	± 10%	± 5%
Гибко-жесткие платы	Y	Y
Гибкие платы	Y	Y
Платы на металлическом основании	Платы на алюминиевом основании	Платы на медном основании, гибкие платы на алюминиевом основании, многослойные платы на алюминиевом основании
Встроенные компоненты		Y
Заполнение отверстий маской IPC4761 Type VI	Y	Y
Заполнение отверстий эпоксидной смолой	Y	Y
Заполнение отверстий эпоксидной смолой IPC4761 Type VII		Y



 info.pcb@npkexpert.ru
 +7(495)560-48-57
 www.npkexpert.ru